

1. Толщина материала:

- Однослойные и двуслойные печатные платы - 0,2мм -3,8мм
- Многослойные печатные платы - 0,4мм-3,8мм

2. Максимальные размеры печатной платы:

- Однослойные и двуслойные печатные платы 700x1500мм
- Многослойные печатные платы 600x1500мм

3. Минимальный диаметр отверстия: 0,1мм (лазерное сверление) и 0,15мм (механическое сверление)**4. Минимальный проводник/зазор между проводниками:** 3mil/3mil**Требования к документации для изготовления:****1. Файлы печатной платы в формате Gerber RS274.**

2. Техническое описание печатной платы – количество слоев, материал печатной платы, список слоев с указанием гербер файла, соответствующего слою, толщина меди, финишное покрытие контактных площадок, особые требования.

3. Сборочный чертеж в графическом формате.**4. Спецификация изделия в текстовом либо табличном исполнении.****Технические требования к изделию:**

1. По возможности располагать все компоненты поверхностного монтажа на одной стороне изделий. При необходимости использования обеих сторон платы для разводки, все тяжелые компоненты рас положить на одной стороне.
2. Использовать посадочные места компонентов, рекомендуемые производителем для технологии поверхностного монтажа.
3. Не располагать отверстия, в том числе переходные, на площадках смд компонентов. Металлизация отверстия должна в обязательном порядке быть отделена паяльной маской от площадки смд компонента.
4. По возможности не располагать SMD компоненты ближе 5мм от края печатной платы по двум противоположным сторонам
5. На печатной плате должны быть реперные знаки в виде 1мм металлических пятчиков с открытием вокруг маски на 2мм в зоне свободной от каких-либо проводников и надписей или свободное место для их расположения

Технологические возможности сборочной линии:

1. Минимальный типоразмер компонента – 0201
2. Минимальный шаг микросхемы - 0,4мм
3. Максимальный размер микросхемы - 45x45мм
4. Максимальный размер платы – 480x480мм